

■ 电路板高度检测功能

自动检测电路板的翘曲。
配合电路板的高度进行元件安装。
可实现低冲击条件下的元件安装。



■ 特殊吸嘴 & 机械夹头

对于标准吸嘴对应困难的元件，
可以通过使用特殊吸嘴或机械
夹头实现安定贴装。



● 通用机械夹头

夹紧元件的爪和顶住元件的
爪块均备有多种尺寸，能以
各种各样的组合对应多品种
生产。



爪和爪块可以各自进行安装
位置的变更和不同尺寸的更换。

· 基本套件 (本体1、爪3套、爪块3套)
· 完整套件 (本体1、爪8套、爪块8套)

■ 电路板支撑

● 自动支撑销

可以设置在任意位置，也可以
自动确认、修正销位置。因而
可以大幅缩短换线时间。



● 软支撑销

可以缓和在贴装时对电路板产
生的冲击，并且可以支持销支
撑有困难的电路板，因此可强
力支援高密度贴装。



■ 导入Fujitrac可强力支持贴装工序

※Fujitrac：贴装工序管理系统（软件）

- 防止元件的上料错误
- 使用元件残数管理功能显示料尽预告
- 显示供料器维修保养预告
- 在机器运转中，可以在空料槽上安装次料站
- 料盘元件的无停止供应功能
- 取得电路板的可跟踪性数据
(需要在电路板粘贴ID、并需要ID读取装置)

	M3 IIc	M6 IIc
对象电路板尺寸 (L x W)	48 mm x 48 mm ~ 250 mm x 290 mm (双搬运轨道规格) 48 mm x 48 mm ~ 250 mm x 380 mm (单搬运轨道规格) * 双搬运轨道 (W) 时最大170 mm, 超过170mm时变为单搬运轨道搬运。	48 mm x 48 mm ~ 534 mm x 290 mm (双搬运轨道规格) 48 mm x 48 mm ~ 534 mm x 380 mm (单搬运轨道规格) * 双搬运轨道 (W) 时最大170 mm, 超过170mm时变为单搬运轨道搬运。
元件种类	MAX 20种类 (8 mm料带换算)	MAX 45种类 (8 mm料带换算)
电路板加载时间	双搬运轨道：连续运转时 0 sec、单搬运轨道：2.5 sec (M3 IIc 各模组间搬运)、3.4 sec (M6 IIc 各模组间搬运)	
贴装精度/涂敷位置精度 (以基准定位为基准)	V12/H12HS: ±0.038(±0.050) mm (3σ) cpk ≥ 1.00 * H04S: ±0.040 mm (3σ) cpk ≥ 1.00 H08: ±0.050 mm (3σ) cpk ≥ 1.00 H02/H01/G04: ±0.030 mm (3σ) cpk ≥ 1.00 GL: ±0.100 mm (3σ) cpk ≥ 1.00 * ±0.038mm是在本公司最合适条件下测定的矩形芯片(高精度调整)贴装精度。	V12/H12HS: ±0.038(±0.050) mm (3σ) cpk ≥ 1.00 * H08M/H04S: ±0.040 mm (3σ) cpk ≥ 1.00 H08/OF: ±0.050 mm (3σ) cpk ≥ 1.00 H02/H01/G04: ±0.030 mm (3σ) cpk ≥ 1.00 GL: ±0.100 mm (3σ) cpk ≥ 1.00 * ±0.038mm是在本公司最合适条件下测定的矩形芯片(高精度调整)贴装精度。
产能	V12 : 26,000 cph (V-Advance 27,500 cph) H12HS : 22,500 cph H08 : 10,500 cph H01 : 4,200 cph GL : 16,363 dph (0.22sec/dot)	H04S : 9,500 cph H02 : 5,500 cph G04 : 6,800 cph
对象元件	V12/H12HS: 0402~7.5 mm x 7.5 mm H08M: 0603~45 mm x 45 mm H08: 0402~12 mm x 12 mm H04S: 1608~38 mm x 38 mm H02/H01/OF: 1608~74 mm x 74 mm (32 mm x 180 mm) G04: 0402~15 mm x 15 mm	高度: 最大3.0 mm 高度: 最大13.0 mm 高度: 最大6.5 mm 高度: 最大6.5 mm 高度: 最大25.4 mm 高度: 最大6.5 mm
模组宽度	320 mm	645 mm
机器尺寸	L: 1295 mm (M3 IIc x 4, M6 IIc x 2) / 645 mm (M3 IIc x 2, M6 IIc) W: 1441.5 mm H: 1476 mm	
元件供应装置		
智能供料器	对应 4·8·12·16·24·32·44·56·72·88·104 mm 宽度料带	
管装供料器	4 ≤ 元件宽 ≤ 15 mm (6 ≤ 料管宽 ≤ 18 mm)、15 ≤ 元件宽 ≤ 32 mm (18 ≤ 料管宽 ≤ 36mm)	
料盘单元	对应料盘尺寸 135.9 x 322.6 mm (JEDEC规格) (料盘单元-M)、276 x 330 mm (料盘单元-LT)、143 x 330 mm (料盘单元-LTC)	
选项		
● 料盘供料器 ● PCU IIc (供料托架更换单元) ● MCU IIc (模组更换单元) ● 管理电脑置放台 ● FUJII CAMX Adapter ● Fujitrac		

模组型高速多功能贴片机

NXT IIc

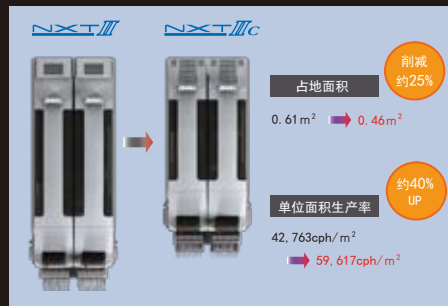
Fuji Scalable Placement Platform

重视现场生产率的紧凑式规格

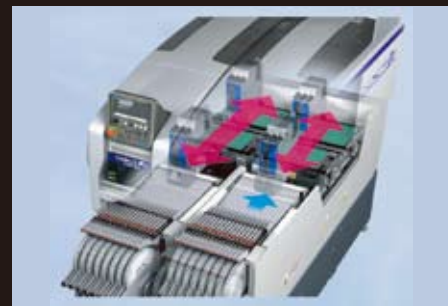


- 在保持NXT II理念的同时提高了现场生产率
- 占地面积压缩了约**25%**、由此可以提高约**40%**的单位面积生产率
- 与高速贴装工作头V12相组合，进一步实现了高生产率

力求提高单位面积生产率的紧凑式设计



NXT IIIc是定位于紧凑式设计的元件贴片机。与NXT II相比，纵深可以缩短485mm，进一步提高了单位面积生产率。

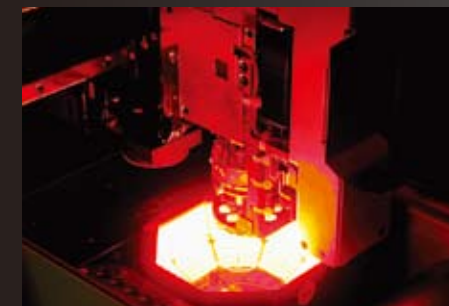


使用搭载了元件识别相机的高速贴装工作头V12时，可以在拆除机器侧的元件识别相机后将料站位置前移到拆除位置（料站前进机构），这样可以进一步提高V12的实装能力。
26,000 cph → 27,500 cph *选购件（仅M3 IIIc）

保持高生产率



准备了从对应芯片元件到对应异型元件的各种贴装工作头和胶着剂涂敷工作头。可以免工具简单装卸，因此在切换产品种时能够配合其用途更换为最佳工作头。



可以根据更换工作头后的状况自动执行元件识别相机、定位相机、吸嘴中心等校正作业，始终保持高精度贴装。



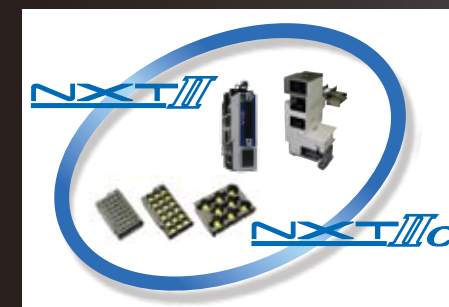
构筑背靠背生产线时，仅需60mm的模组间隔（70mm的底座间隔）即可完成设置。由此可以在狭小的生产空间内设置更多的NXT IIIc模组。



由于双搬运轨道可以进行异种电路板生产，因此可以灵活应对多品种少批量生产。并且可以通过削减加载时间提高运转率。



操作面板采用图形用户界面。直观的操作系统不要求操作者的技能，还可以缩短教育培训时间。



在NXT II上使用的单元也可以使用于NXT IIIc，形成了NXT II资产的有效利用。
* 存在部分不能挪用的单元。



■ 与NXT II共通 ■ NXT IIIc专用

■ 料站供料托架

- M3 IIIc用20料槽
- M3 IIIc用20斗式料槽
- M6 IIIc用45料槽
- M6 IIIc用45斗式料槽

■ 智能供料器

- W04b ● W08c
- W12 ● W16
- W24 ● W32
- W44 ● W56
- W72 ● W88
- W104

■ 料卷托架

- W4/ 7英寸
- W12/ 7,15英寸
- W24/ 15英寸
- W44/ 15英寸
- W72/ 15英寸
- W104/ 15英寸
- W 8/ 7,13英寸
- W16/ 15英寸
- W32/ 15英寸
- W56/ 15英寸
- W88/ 15英寸

■ 吸嘴置放台

- V12/ H12HS(Q)/ H08(Q)用（共用）
- H08M用（4种类型）
- H04S用（4种类型）
- H01/ H02用（7种类型）
- G04用（4种类型）
- OF用（5种类型）

■ 贴装工作头

- V12/ H12HS(Q)（12吸嘴）
- H08M/ H08(Q)（8吸嘴）
- H04S（4吸嘴）
- H02（2吸嘴）
- H01（1吸嘴）
- G04(Q)（4吸嘴）
- OF工作头（插入·异形元件用）
- GL工作头（胶着剂涂敷）

■ 模组本体

- M3 IIIc
- M6 IIIc

■ 料盘单元（可搭载在M6 IIIc）

- 料盘单元-M
- 料盘单元-LT
- 料盘单元-LTC



■ 定位相机

■ 主搬运轨道

- 单搬运轨道
- 双搬运轨道

■ 模组基座

- 4M IIIc基座
- 2M IIIc基座

■ 元件相机

- 标准 ● 高分辨率
- 侧光 ● P03 ● P05

更换单元

■ 供料托架更换单元（PCU IIIc）

※以供料托架为单位一次性更换供料器的单元。

- M3 IIIc用
- M3 IIIc斗式用
- M6 IIIc用
- M6 IIIc斗式用

■ 模组更换单元（MCU IIIc）

※更换模组的单元。M3 IIIc可搭载2台。

- M3 IIIc/ M6 IIIc共用